



985M Flux Liquido

Bajo-Solidos No-Clean Flux

Descripción del Producto

Kester 985M no-clean flux es bajo en sólidos, libre de haluros, que está diseñado para soldadura por ola y para procesos de retoque. El 985M fue desarrollado para su uso con aleaciones de soldadura sin plomo y de estaño-plomo. 985M exhibe un excelente desempeño minimizando/eliminando los puentes de soldadura (cortos) durante todas las operaciones de soldado. Este flux es adecuado para aplicaciones automotrices, informáticas, de telecomunicaciones y otras en las que las cuestiones de confiabilidad sean críticas. Según lo probado bajo las especificaciones J-STD-004B, el 985M está clasificado como Tipo ROL0.

Características:

- Mejora el rendimiento de la soldadura.
- Elimina la necesidad y el gasto de la limpieza.
- Residuos no corrosivos y no pegajosos
- Clasificado como ROL0 por J-STD-004B
- Cumple con Bellcore GR-78

Conformidad con RoHS

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS). La información adicional de RoHS se encuentra en <https://www.kester.com/downloads/environmental>.

Propiedades Físicas

Gravedad Especifica @ 25°C: 0.805 (típica)

Valor Ácido (típico): 20.0 mg KOH/g de flux

Porcentaje de Sólidos (teórica): 3.6%

Confiabilidad

Corrosión en espejo de cobre: Bajo
Probado según J-STD-004, IPC-TM-650, Método 2.3.32

Resistencia aislante de la superficie (SIR): Pasa
Probado según J-STD-004B, IPC-TM-650 Método 2.6.3.7.
Condiciones de la prueba: 40°C, 90% RH, 7 días, 12.5V

Fluoruros por prueba puntual: Pasa
Probado según J-STD-004, IPC-TM-650, Método 2.3.35.1

Corrosión: Bajo
Probado según J-STD-004, IPC-TM-650, Método 2.6.15

Resistencia aislante de la superficie (SIR) - Bellcore: Pasa
Probado según GR-78-CORE Sección 13.1.3
Condiciones de la prueba: 35°C, 85% RH, 4 días, 100V

Resistencia aislante de la superficie (SIR): Pasa
Probado según J-STD-004, IPC-TM-650, Método 2.6.3.3
Condiciones de la prueba: 85°C, 85% RH, 7 días, 100V

Prueba de corrosión Bono: Pasa;
Fc=0.7%
Condiciones de la prueba: 85°C, 85% RH, 15 días, 12V

Cromato de Plata: Pasa
Probado según J-STD-004, IPC-TM-650, Método 2.3.33

Migración Electroquímica (ECM): Pasa
Probado según J-STD-004B, IPC-TM-650 Método 2.6.14.1
Condiciones de la prueba: 65°C, 85% RH, 500hrs, 100V

Cloruros y Bromuros: No Detectados
Probado según J-STD-004, IPC-TM-650, Método 2.3.35

Aplicación del flux

985M está especialmente diseñado para aplicaciones de rociado (spray) y olas. No está diseñado para usarse en una aplicación de espuma (foam). El objetivo de deposición de flujo debe comenzar con 90-190 μg de sólidos / cm^2 (600-1200 μg de sólidos / in^2).

Consideraciones de proceso

La temperatura de precalentamiento óptima para la mayoría de los ensamblajes es de 85-105°C (185-221°F), tomada en la parte superior o lado de los componentes del ensamblaje. Es importante tener en cuenta que la temperatura óptima de precalentamiento para un ensamblaje determinado dependerá de la combinación del diseño de la máquina, el diseño del circuito (masa o tamaño de la tarjeta y mezcla de componentes), el grosor de la tarjeta, la duración del tiempo de contacto con la soldadura fundida, la forma de onda de la soldadura, velocidad de flujo de la soldadura, tiempo de precalentamiento y aleación utilizada en el pot de soldadura. La clave es precalentar la tarjeta para iniciar la activación del flux, pero no quemarlo antes de llegar al pot de soldadura líquida. Para 985M, la temperatura máxima de precalentamiento en el lado inferior de la tarjeta es de 130°C.

Las soldaduras con plomo (Sn63Pb37) requerirán un tiempo de contacto de 2-4 segundos. Las soldaduras sin plomo (Sn96.5Ag3.0Cu0.5) requerirán un tiempo de contacto en la ola de 4-7 segundos. Valores superiores a los 7 segundos, pudieran producir disolución de cobre en las tarjetas terminado OSP, ImAg e ImSn.

La información anterior es una guía y es aconsejable tener en cuenta que la configuración óptima para un conjunto dado puede variar y esto depende del diseño de la tarjeta, el grosor de la tarjeta, los componentes utilizados y el equipo utilizado. Se recomienda realizar un diseño de experimento para optimizar el proceso de soldado. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Soporte técnico de Kester.

Retoque

Las plumas de flux (flux pen) solo deben usarse como último recurso. Cualquier flux aplicado a la ubicación de la soldadura debe mantenerse en la misma ubicación de la conexión de soldadura que se está soldando.

Control del flux

El kit de prueba Kester PS-22 y el procedimiento de dicha prueba están disponibles para asegurar el correcto nivel de sólidos en el flux. Las instrucciones de cómo usar este kit vendrán incluidas con la compra. Este kit también podría usarse como un medio de inspección de entrada.

Limpieza

Los residuos del flux 985M no son conductivos, no son corrosivos y no requieren de limpieza en la mayoría de las aplicaciones. Si se requiere la eliminación de dichos residuos, se pueden retirar con facilidad con la mayoría de los limpiadores de fundente disponibles comercialmente. Póngase en contacto con el soporte técnico de Kester si requiere asistencia adicional.

Almacenamiento y vida útil

985M es inflamable. Almacénelo lejos de fuentes de ignición. La vida útil es de 1 año a partir de la fecha de fabricación cuando se maneja adecuadamente y se mantiene a 10-25°C (50-77°F).

Salud y Seguridad

Este producto, durante su uso o manipulación, puede ser peligroso para su salud o el medio ambiente. Lea la hoja de datos de seguridad y etiqueta de advertencia antes de usar este producto. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en <https://www.kester.com/downloads/sds>.

Información Adicional

La información adicional del producto está disponible en el paquete de datos 985M. Póngase en contacto con su representante de Kester para obtener una copia.